

中国芯片设计行业发展趋势分析与未来前景研究 报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国芯片设计行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202402/691929.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

芯片设计又被称为电路设计，是指以集成电路，超大规模集成电路为目标的设计流程。随着当前AI、5G、物联网、云计算等行业的发展，对芯片的需求也不断增多，而这也带动了芯片的研发和设计。从市场来看，目前我国芯片设计相关企业有国科微、华为海思、力合微、兆易创新、寒武纪-U和紫光国微等企业，其中华为海思主要是面向智能终端、显示面板、家电、汽车电子等行业提供感知、联接、计算、显示等端到端的板级芯片和模组解决方案，产品覆盖智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧出行、显示交互、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。

我国芯片设计相关企业情况

公司简称

成立时间

主营业务

竞争优势

国科微 (300672)

2008年

芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务

产品优势：公司各产品线在自主创新的核心技术基础上,在视频解码、视频编码、固态存储、物联网等领域推出了系列全自主、低功耗、高性价比的芯片产品。

研发优势：公司每年将营业收入的20%以上用于研发,先后承担了国家科技重大专项、国家重点研发计划等一系列重大科研项目,在先进工艺制程的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。

华为海思

2004年

主要是面向智能终端、显示面板、家电、汽车电子等行业提供感知、联接、计算、显示等端到端的板级芯片和模组解决方案。

产品布局优势：产品覆盖智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧出行、显示交互、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。

研发优势：在中国、新加坡、韩国、日本、欧洲等地设有12个办事处和研发中心，产品和服务遍布全球100多个国家和地区。

力合微 (688589)

2002年

物联网通信技术及芯片设计

资质优势：公司是国家高新技术企业,广东省及深圳市“电力线载波通信工程研究中心”依托单位,凭借自主核心技术研发优势,创新优势,先后荣获:国家工信部专精特新“小巨人”企业、深圳

市科学技术奖(标准奖) 等荣誉。

技术优势：公司在PLC技术和芯片领域处于行业领先地位,具有全系列芯片、产品开发及完整解决方案制定的丰富经验,公司也是多项相关国家标准的主要起草单位。

兆易创新 (603986)

2005年

主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。

规模优势：公司在中国北京、上海、深圳、合肥、西安、成都、苏州、香港和台湾,美国、韩国、日本、英国、新加坡等多个国家和地区均设有分支机构和办事处,营销网络遍布全球,为客户提供优质便捷的本地化支持服务。

产品优势：公司的核心产品线为FLASH、32位通用型MCU及智能人机交互传感器芯片及整体解决方案,公司产品以“高性能、低功耗”著称,为工业、汽车、计算、消费类电子、物联网、移动应用以及网络和电信行业的客户提供全方位服务。

寒武纪-U (688256)

2016年

各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售

专利优势：截至2022年6月30日,公司累计申请的专利为2607项,按照专利地域可分为:境内专利申请1697项,境外专利申请646项,PCT专利申请264项;按照专利类型可分为:发明专利申请2537项,实用新型专利申请34项,外观设计专利申请36项。公司累计已获授权的专利为698项,按照专利地域可分为:境内专利514项,境外专利184项;按照类型可分为:发明专利633项,实用新型专利32项,外观设计专利33项。此外,公司拥有软件著作权61项;集成电路布图设计6项。

产品体系优势：目前,公司已推出的产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片及其加速卡、训练整机、处理器IP及软件,可满足云、边、端不同规模的人工智能计算需求。

紫光国微 (002049)

2001年

特种集成电路、智能安全芯片

资质优势：在主要业务领域拥有相关核心技术,曾获国家科技进步一等奖、二等奖,国家技术发明二等奖等权威奖项,旗下主要产业均为高新技术企业,并获国家企业技术中心、国家级“专精特新”小巨人企业认定。

客户优势：公司主要从事芯片研发设计,晶圆制造和封装测试主要采用外协加工的形式,已和业内主流代工企业形成长期合作伙伴关系,为公司的产能提供充分保障。

资料来源：公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看，2023年前三季度国科微营业收入31.90亿元，同比增长9.45%，归母净利润0.78亿元，同比下降33.77%；力合微营业收入为4.48亿元，同比增长28.25%；归母净利润为8136.64万元，同比增长58.30%；兆易创新营业收入为43.94亿元，同比下降35.08%，归母净利润为4.34亿元，同比下降79.27%。

2023年前三季度我国芯片设计行业相关企业营业收入 公司简称 营业收入 同比增长
归母净利润 同比增长 国科微 (300672) 31.90亿元 9.45% 0.78亿元 -33.77% 力合微
(688589) 4.48亿元 28.25% 8136.64万元 58.30% 兆易创新 (603986) 43.94亿元 -35.08%
4.34亿元 -79.27% 寒武纪-U (688256) 1.46亿元 -44.84% -8.08亿元 14.51% 紫光国微
(002049) 56.42亿元 14.31% 20.31亿元 -0.48%

资料来源：公司资料、观研天下整理

从投融资来看，2021年之后我国芯片设计行业相关投融资事件和投融资金额都为下降趋势，到2023年我国芯片设计行业相关投融资事件约188起，已披露投融资金额约366.48亿元。2024年1-2月2日，行业投融资数量共25起，投资金额为22.73亿元。

资料来源：IT桔子

2023年我国芯片设计行业共发生投融资事件188起，其中投融资金额最高为9月，投资金额为150.5亿元。

资料来源：IT桔子

2024年1-2月2日我国芯片设计行业共发生25起投融资事件，其中投融资金额最高为思必驰获得Pre-IPO投资，金额2亿人民币。

2024年2月1-2日我国芯片设计行业投融资事件情况

时间	公司简称	轮次	投资金额
2024-02-02	安森德	战略投资	未透露
2024-02-01	云途半导体	战略投资	未透露
2024-02-01	线易微电子	Pre-A轮	数千万人民币

资料来源：IT桔子（XD）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国芯片设计行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国芯片设计行业发展概述

第一节 芯片设计行业发展情况概述

一、芯片设计行业相关定义

二、芯片设计特点分析

三、芯片设计行业基本情况介绍

四、芯片设计行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、芯片设计行业需求主体分析

第二节 中国芯片设计行业生命周期分析

一、芯片设计行业生命周期理论概述

二、芯片设计行业所属的生命周期分析

第三节 芯片设计行业经济指标分析

一、芯片设计行业的赢利性分析

二、芯片设计行业的经济周期分析

三、芯片设计行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球芯片设计行业市场发展现状分析

第一节 全球芯片设计行业发展历程回顾

第二节 全球芯片设计行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲芯片设计行业地区市场分析

一、亚洲芯片设计行业市场现状分析

二、亚洲芯片设计行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲芯片设计行业市场前景分析

第四节 北美芯片设计行业地区市场分析

一、北美芯片设计行业市场现状分析

二、北美芯片设计行业市场规模与市场需求分析

三、北美芯片设计行业市场前景分析

第五节 欧洲芯片设计行业地区市场分析

一、欧洲芯片设计行业市场现状分析

二、欧洲芯片设计行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲芯片设计行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界芯片设计行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球芯片设计行业市场规模预测

第三章 中国芯片设计行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对芯片设计行业的影响分析

第三节中国芯片设计行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对芯片设计行业的影响分析

第五节中国芯片设计行业产业社会环境分析

第四章 中国芯片设计行业运行情况

第一节中国芯片设计行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国芯片设计行业市场规模分析

一、影响中国芯片设计行业市场规模的因素

二、中国芯片设计行业市场规模

三、中国芯片设计行业市场规模解析

第三节中国芯片设计行业供应情况分析

一、中国芯片设计行业供应规模

二、中国芯片设计行业供应特点

第四节中国芯片设计行业需求情况分析

一、中国芯片设计行业需求规模

二、中国芯片设计行业需求特点

第五节中国芯片设计行业供需平衡分析

第五章 中国芯片设计行业产业链和细分市场分析

第一节中国芯片设计行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、芯片设计行业产业链图解

第二节中国芯片设计行业产业链环节分析

- 一、上游产业发展现状
- 二、上游产业对芯片设计行业的影响分析
- 三、下游产业发展现状
- 四、下游产业对芯片设计行业的影响分析
- 第三节我国芯片设计行业细分市场分析
 - 一、细分市场一
 - 二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国芯片设计行业市场竞争分析

- 第一节中国芯片设计行业竞争现状分析
 - 一、中国芯片设计行业竞争格局分析
 - 二、中国芯片设计行业主要品牌分析
- 第二节中国芯片设计行业集中度分析
 - 一、中国芯片设计行业市场集中度影响因素分析
 - 二、中国芯片设计行业市场集中度分析
- 第三节中国芯片设计行业竞争特征分析
 - 一、企业区域分布特征
 - 二、企业规模分布特征
 - 三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国芯片设计行业模型分析

- 第一节中国芯片设计行业竞争结构分析（波特五力模型）
 - 一、波特五力模型原理
 - 二、供应商议价能力
 - 三、购买者议价能力
 - 四、新进入者威胁
 - 五、替代品威胁
 - 六、同业竞争程度
 - 七、波特五力模型分析结论
- 第二节中国芯片设计行业SWOT分析
 - 一、SOWT模型概述
 - 二、行业优势分析
 - 三、行业劣势
 - 四、行业机会
 - 五、行业威胁

六、中国芯片设计行业SWOT分析结论

第三节中国芯片设计行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国芯片设计行业需求特点与动态分析

第一节中国芯片设计行业市场动态情况

第二节中国芯片设计行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节芯片设计行业成本结构分析

第四节芯片设计行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国芯片设计行业价格现状分析

第六节中国芯片设计行业平均价格走势预测

一、中国芯片设计行业平均价格趋势分析

二、中国芯片设计行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国芯片设计行业所属行业运行数据监测

第一节中国芯片设计行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国芯片设计行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国芯片设计行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国芯片设计行业区域市场现状分析

第一节中国芯片设计行业区域市场规模分析

- 一、影响芯片设计行业区域市场分布的因素
- 二、中国芯片设计行业区域市场分布

第二节中国华东地区芯片设计行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 华东地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 华东地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 华东地区芯片设计行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 华中地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 华中地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 华中地区芯片设计行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 华南地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 华南地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 华南地区芯片设计行业市场规模预测

第五节华北地区芯片设计行业市场分析

- 一、华北地区概述
- 二、华北地区经济环境分析

三、华北地区芯片设计行业市场分析

- (1) 华北地区芯片设计行业市场规模
- (2) 华北地区芯片设计行业市场现状
- (3) 华北地区芯片设计行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

- 一、东北地区概述
- 二、东北地区经济环境分析
- 三、东北地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 东北地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 东北地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 东北地区芯片设计行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 西南地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 西南地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 西南地区芯片设计行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析
- 三、西北地区芯片设计行业市场分析
 - (1) 西北地区芯片设计行业市场规模
 - (2) 西北地区芯片设计行业市场现状
 - (3) 西北地区芯片设计行业市场规模预测

第十一章 芯片设计行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
 - 1、主要经济指标情况
 - 2、企业盈利能力分析
 - 3、企业偿债能力分析
 - 4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国芯片设计行业发展前景分析与预测

第一节中国芯片设计行业未来发展前景分析

一、芯片设计行业国内投资环境分析

二、中国芯片设计行业市场机会分析

三、中国芯片设计行业投资增速预测

第二节中国芯片设计行业未来发展趋势预测

第三节中国芯片设计行业规模发展预测

一、中国芯片设计行业市场规模预测

二、中国芯片设计行业市场规模增速预测

三、中国芯片设计行业产值规模预测

四、中国芯片设计行业产值增速预测

五、中国芯片设计行业供需情况预测

第四节中国芯片设计行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国芯片设计行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国芯片设计行业进入壁垒分析

一、芯片设计行业资金壁垒分析

二、芯片设计行业技术壁垒分析

三、芯片设计行业人才壁垒分析

四、芯片设计行业品牌壁垒分析

五、芯片设计行业其他壁垒分析

第二节芯片设计行业风险分析

一、芯片设计行业宏观环境风险

二、芯片设计行业技术风险

三、芯片设计行业竞争风险

四、芯片设计行业其他风险

第三节中国芯片设计行业存在的问题

第四节中国芯片设计行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国芯片设计行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国芯片设计行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国芯片设计行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节芯片设计行业营销策略分析

一、芯片设计行业产品策略

二、芯片设计行业定价策略

三、芯片设计行业渠道策略

四、芯片设计行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202402/691929.html>